

(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006 年 1 月 12 日 (12.01.2006)

PCT

(10) 国
WO 2006/003798 A1

- (51) 国際特許分類⁷: GOIK 7/02, 1/14, HOIL 21/66
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/01 1131
(22) 国際出願日: 2005 年 6 月 17 日 (17.06.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権一タ:
特願 2004-195968 2004 年 7 月 1 日 (01.07.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2 5 0 0 番地 Kanagawa (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井佳詞 (Fujii, Yoshinori) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山 1 2 2 0 - 1 4 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 飯阪泰雄 (HISAKA, Yasuo); 〒2310007 神奈川県横浜市中区弁天通 6 T 目 8 5 番 宇徳ビル Kanagawa (JP).

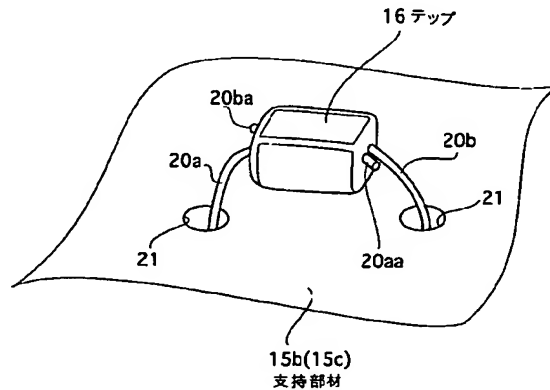
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, E., FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -x- ラシ T (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

/続葉有/

(54) Title: SUBSTRATE TEMPERATURE MEASURING APPARATUS AND PROCESSOR

(54) 発明の名称: 基板温度測定装置及び処理装置



16 CHIP
15b(15c) SUPPORTING MEMBER

(57) Abstract: A substrate temperature measuring apparatus which can stably and accurately measure temperature of a substrate by improving reliability of a thermocouple wire and reducing infrared ray influence on a chip, and a processor are provided. A chip (16) is composed of a metal material which reflects infrared rays, is provided with an inserting part (16a) of the thermocouple wires (20a, 20b), and is brought into contact with a substrate (13) by being integrated with the thermocouple wires (20a, 20b) by being deformed to crush the inserting part (16a) in a status where the thermocouple wires (20a, 20b) are inserted into the inserting part (16a). The substrate temperature measuring apparatus is provided with the chip (16) and a supporting member (15b (15c)) which is composed of a material having a lower heat conductivity than that of the chip (16) for supporting the chip (16).

(57) 要約: 熱電対素線の信頼性を高めると共に、チップに対する赤外線の影響を低減して、基板の温度を安定して正確に測定できる基板温度測定装置及び処理装置を提供すること。赤外線を反射する金属材料からなり、熱電対素線 20a、20b の挿入部 16a を有し、その挿入部 16a に熱電対素線 20a、20b が挿入された状態で挿入部 16a をつぶすように変形

/続葉有/

WO 006/00 798



BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, R, SE, SI, SK, TR),
OAPI の F, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

されて熱電対素線 20 a、20 b と一体とされ基板 13 に接触されるチップ 16 と、このチップ 16 よりも熱伝導
の小さい材料からなり、チップ 16 を支持する支持部材 15 b (15 c) とを備える。